



【東京/武蔵村山】品質保証リーダー候補 ◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。品質管理・品質保証（技術系）のご経験...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

ヤマハロボティクス株式会社

求人ID

1594516

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

その他東京

給与

450万円～750万円

勤務時間

08:45～17:30

休日・休暇

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日～15日 4か月目から【休日】完全週休二日制...

更新日

2026年06月11日 07:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

専門学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2335254】

■組織構成：組織：品質保証部

■業務内容

品質不具合対応、再発未然防止、信頼性評価など、品質保証業務全般を担当いただきます。
1.市場および自社内品質不具合の一次故障解析と再発・未然防止実施までのフォローアップ
2.監査を含む協力会社（日本国内および海外サプライヤ）の品質管理

- 3.新規開発品の品質・信頼性評価およびDR（デザインレビュー）を含む開発ゲート管理
- 4.品質情報のデジタル化推進およびデータ活用による品質改善
- 5.品質マネジメントシステム（QMS）の更新・維持・管理

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競争が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

[取扱い製品]

ワイヤボンダ、ダイボンダ、パンプボンダ、フリップチップボンダ、等

□主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

スキル・資格

■必須（主務クラスに求めている内容）

- ・機械系メーカーでの品質保証経験
- ・以下のいずれかのご経験
故障解析～再発・未然防止/サプライヤ管理/信頼性評価/DR/品質情報管理のDX化/QMSの維持管理

■尚可（主務クラスに求めている内容）

- ・マネジメント経験や社内および協力会社への品質改善指導経験

会社説明

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。